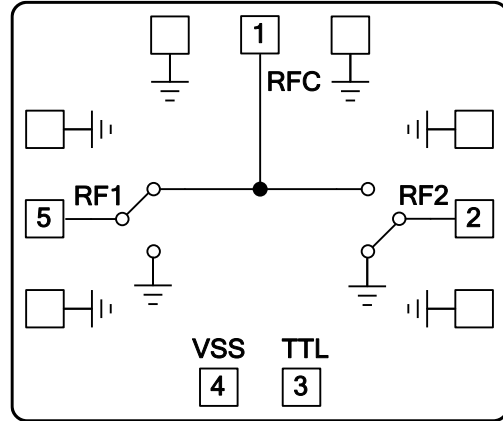




主要特点

- 隔离度: >38 dB @ 4 GHz
- 插入损耗: 0.6 dB @ 4 GHz
- 反射式设计
- 供电: -5 V @ 2 mA
- 芯片尺寸: 0.63x 0.75x 0.1 mm³

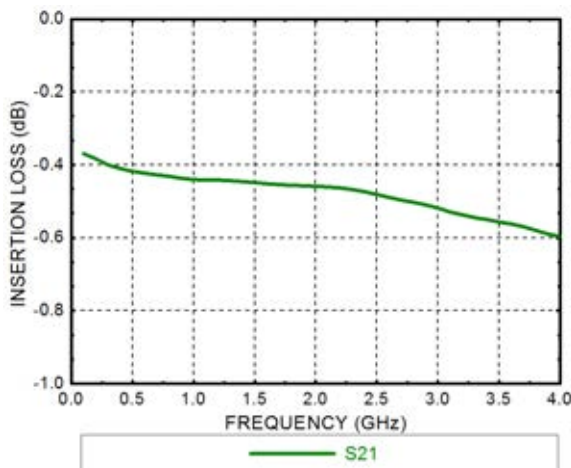
功能框图



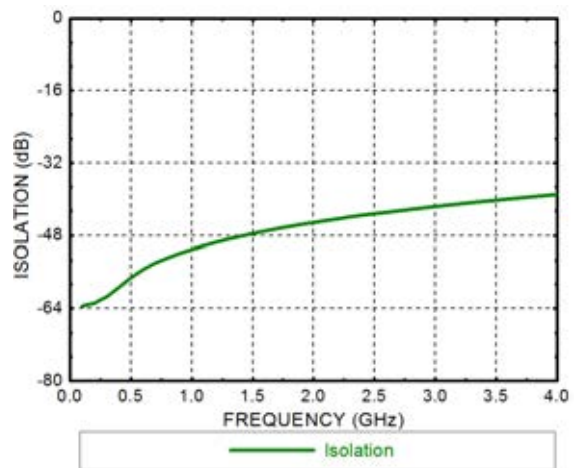
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0/+5\text{ V}$, $V_{SS} = -5\text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 4			GHz
插入损耗		0.5		dB
隔离度		45		dB
回波损耗“打开状态”		20		dB
输入功率 1dB 压缩点 @1-4GHz		25		dBm
开关切换时间		15		ns

插入损耗

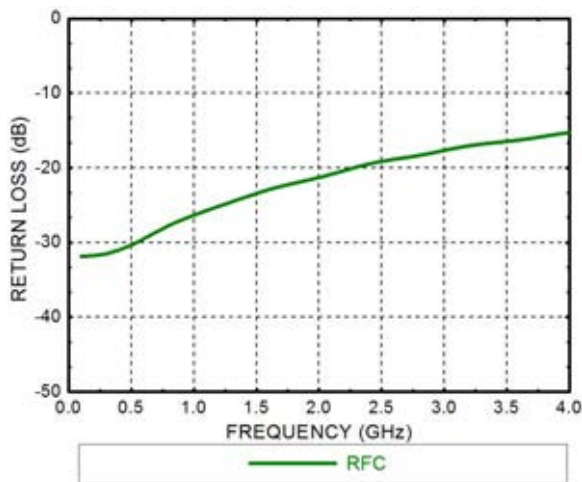


隔离度

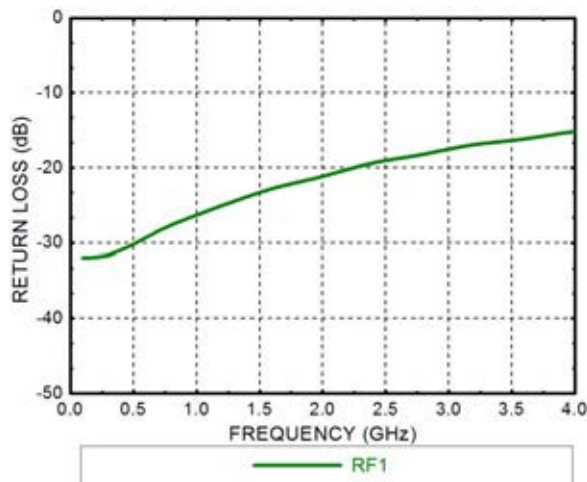




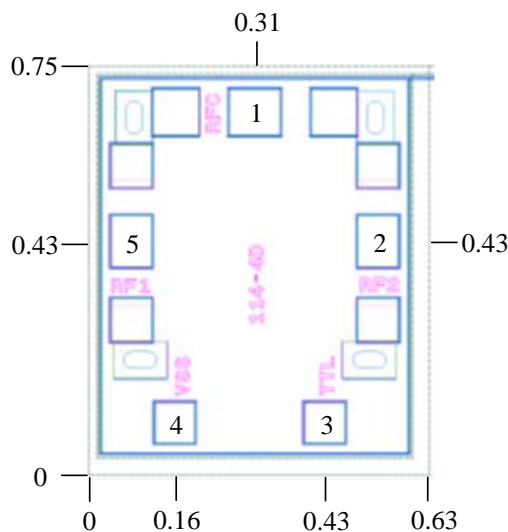
RFC端回波损耗, “ON” 状态



RF1端回波损耗, “ON” 状态



物理参数



焊盘描述

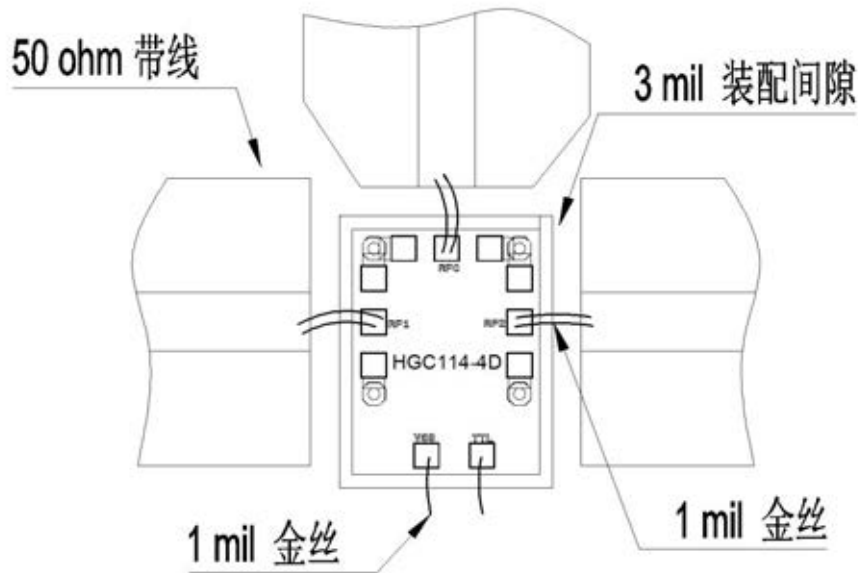
焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2, 5	RF1, RF2	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
3	TTL	TTL 端接 0V 控制电压, 则 RF1 为 “ON” 状态, RF2 为 “OFF” 状态; TTL 端接 +5V 控制电压, 则 RF1 为 “OFF” 状态, RF2 为 “ON” 状态
4	VSS	该焊盘为数字电路电源端, 接 -5V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

功能	VSS	TTL
RFC-RF1	-5V	0
RFC-RF2		1
“0”电平范围: 0~0.5V, “1”电平范围: 3~5V。		

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率: +27 dBm
2. 储存温度: $-65 \sim +175^\circ\text{C}$
3. 工作温度: $-55 \sim +85^\circ\text{C}$